

Beschreibung für MHC 64k-sRAM-Modul

Lötaugen für Durchkontaktierungen sind rund; die für Bauteile sind eckig (siehe auch Layout)

z.T. müssen Leiterbahnen an Bauelementen der BS als Durchkontaktierung mit verlötet werden (bei IC-Fassungen, Schaltern und Tastern ist das aber vermieden wurden)

die Beschriftung der beiden Auswahlschalter beschreibt nur die Schalterstellung; geschlossen sind jeweils die 2 Pins der Gegenseite (hier können natürlich auch Jumper gesetzt werden; ist dann nur nicht so komfortabel)

eine grobe Skizze der Schaltung liegt mit bei (die Datentreibersteuerung erfolgt mit /RD)

Viel Erfolg beim Aufbau

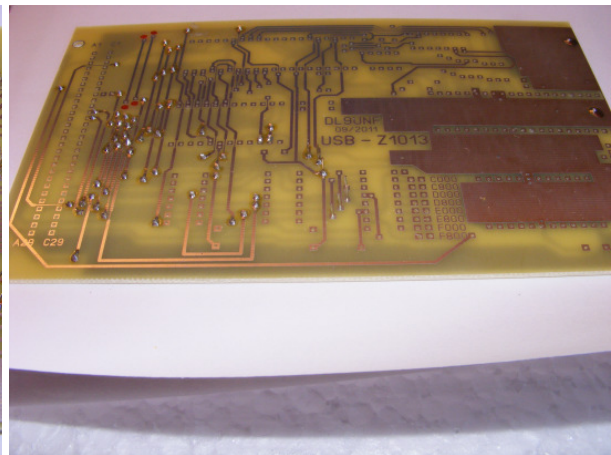
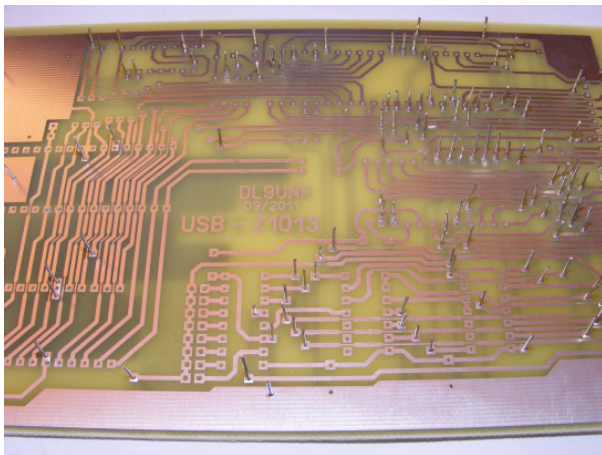
Matthias „Lötspitze“

alle Durchkontaktierungen fertige ich immer als erstes auf folgende Art und Weise:
(siehe Beispiel USB-Platine)

Unterlage aus Styropur, darüber ein Blatt Papier und dann die Platine

verzinnte Drahtstückchen von der Rolle mit ca. 1,5cm Länge werden in alle Durchkontaktierung gesteckt, sodaß noch ca. 5mm oben herausstehen

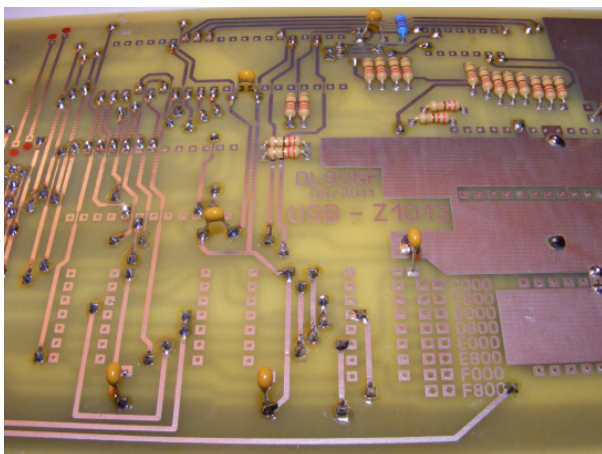
dann wird von außen beginnend die Oberseite verlötet, je nachdem an welche Lötäugen man gerade gut herankommt (was fertig ist, wird auch schon mal per Seitenschneider gekürzt)



ist alles von oben verlötet, wird die Platine vom Styropur abgezogen und das Blatt Papier entfernt

beim nun folgenden identischen Verlöten der Unterseite sollte die Platine auch auf dem Styropur liegen, damit die Drähte in ihrer Position bleiben

nach den Durchkontaktierungen folgen Widerstände, Stützkondensatoren ...



mit dieser Vorgehensweise sind die Durchkontaktierungen und Kleinbauteile relativ schnell erledigt